



Tagesordnung

Thema: 75. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“

Datum: **09. Mai 2022, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin
Online via MS Teams

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Walter, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Modulares Elektronik-Design – Neue Konzepte für langfristig verfügbare Baugruppen
Herr O. Helzle, Hema elektronik GmbH, Aalen
- 3 10:50 Uhr
Experimentelle und numerische Studie zu thermischen Kopplungen von Silizium-Flip-Chips auf FR4 Substrat bei natürlicher oder forcierter Konvektion
Herr T. Nowak, Brandenburger Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg, Senftenberg
- 4 11:30 Uhr
Numerische Simulationen von thermomechanischen Alterungseffekten
Herr M.van Dijk, Fraunhofer IZM, Berlin
- 5 12:00 Uhr
Mittagspause

- 6 13:00 Uhr
„Systematische“ Kombination und Bewertung von umwelt- und betriebsbedingter Degradation
Herr St.Straube, Fraunhofer IZM, Berlin
- 7 13:40 Uhr
Austausch/Brainstorming/Diskussion
 - *weitere Themenfelder (Planung 2022/2023)*
 - *Art der Durchführung (Präsenz/Hybrid/ ?)*
Alle Teilnehmer
- 8 15:00 Uhr

Ende der Veranstaltung gegen 15:00 Uhr